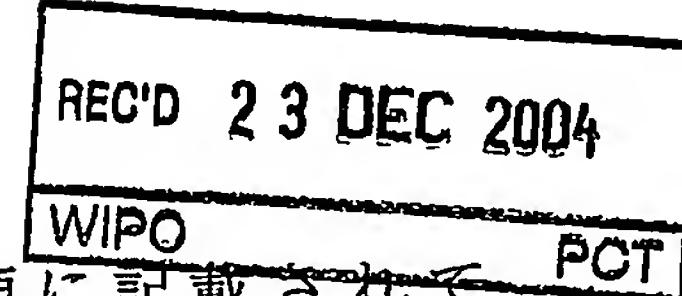


29.10.2004

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日 2003年12月10日  
Date of Application:

出願番号 特願2003-411287  
Application Number:  
[ST. 10/C] : [JP2003-411287]

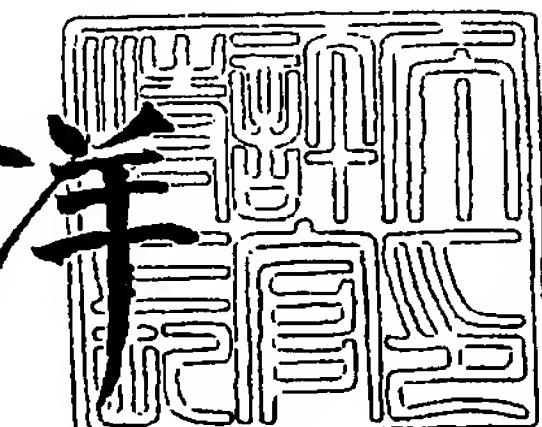
出願人 三菱住友シリコン株式会社  
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月13日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 P02ML015K  
【提出日】 平成15年12月10日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 H01L 21/306  
H01L 21/304

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内  
【氏名】 古屋田 栄

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株式会社内  
【氏名】 高石 和成

【特許出願人】  
【識別番号】 302006854  
【氏名又は名称】 三菱住友シリコン株式会社

【代理人】  
【識別番号】 100085372  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 須田 正義

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 003285  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

**【書類名】特許請求の範囲****【請求項1】**

ラッピング工程に続いて洗浄工程を経た加工変質層を有するシリコンウェーハをフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液にリン酸が含有する酸エッティング液に浸漬させて前記ウェーハをエッティングするシリコンウェーハの加工方法。

**【請求項2】**

フッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液を100重量%としたとき、前記酸水溶液はリン酸を30～40重量%含有する請求項1記載の加工方法。

**【請求項3】**

複数のエッティング槽に酸エッティング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程(11)に続いて洗浄工程(12)を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬するエッティング工程(13)と、

前記エッティングされたウェーハの片面を鏡面研磨する表面鏡面研磨工程(18)と、

前記表面鏡面研磨されたウェーハを洗浄する洗浄工程(19)と

を含むシリコンウェーハの加工方法において、

前記エッティング工程(13)が酸エッティングの後にアルカリエッティングが行われる工程であつて、

前記酸エッティング液がフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液100重量%にリン酸30重量%以上を含有することを特徴とするシリコンウェーハの加工方法。

**【請求項4】**

エッティング工程(13)と、表面鏡面研磨工程(18)との間に前記エッティング工程(13)で形成されたウェーハ裏面の凹凸の一部を研磨する裏面軽研磨工程(17)を更に含む請求項3記載の加工方法。

**【請求項5】**

フッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液を100重量%としたとき、前記酸水溶液はリン酸を30～40重量%含有する請求項3記載の加工方法。

**【請求項6】**

エッティング工程(13)における酸エッティングを、シリコンウェーハへ酸エッティング液を滴下し、前記ウェーハをスピinnさせることにより前記滴下した酸エッティング液をウェーハ表面全体に拡げてエッティングするスピinnコート法により行う請求項3記載の加工方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】シリコンウェーハの加工方法

【技術分野】

## 【0001】

本発明は、シリコンウェーハの製造工程において、発生するウェーハ表面の加工変質層をエッティング除去する方法の改善に関する。更に詳しくは、ウェーハ両面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有しかつウェーハの表裏面を目視により識別可能にするシリコンウェーハの加工方法を提供することにある。

【背景技術】

## 【0002】

一般に半導体シリコンウェーハの製造工程は、引上げたシリコン単結晶インゴットから切出し、スライスして得られたウェーハを、面取り、機械研磨（ラッピング）、エッティング、鏡面研磨（ポリッシング）及び洗浄する工程から構成され、高精度の平坦度を有するウェーハとして生産される。これらの工程は目的により、その一部の工程が入替えられたり、複数回繰返されたり、或いは熱処理、研削等他の工程が付加、置換されたりして種々の工程が行われる。

ブロック切断、外径研削、スライシング、ラッピング等の機械加工プロセスを経たシリコンウェーハは表面にダメージ層即ち加工変質層を有している。加工変質層はデバイス製造プロセスにおいてスリップ転位等の結晶欠陥を誘発したり、ウェーハの機械的強度を低下させ、また電気的特性に悪影響を及ぼすので完全に除去しなければならない。

## 【0003】

この加工変質層を取除くため、エッティング処理が行われる。エッティング処理には、混酸等の酸エッティング液を用いる酸エッティングと、NaOH等のアルカリエッティング液を用いるアルカリエッティングとがある。

しかし、酸エッティングを行うことにより、ラッピングで得られた平坦度が損なわれ、エッティング表面にmmオーダーのうねりやピールと呼ばれる凹凸が発生する。また、アルカリエッティングを行うことにより、局所的な深さが数 $\mu$ mで、大きさが数～数十 $\mu$ m程度のピット（以下、これをファセットという。）が発生する等の問題点があった。

## 【0004】

上記問題点を解決する方法としてアルカリエッティングの後に、酸エッティングを行い、このときのアルカリエッティングの取り代を酸エッティングの取り代より大きくするウェーハの加工方法及びこの方法により加工されたウェーハが提案されている（例えば、特許文献1参照。）。

上記特許文献1に示される方法により、ラッピング後の平坦度を維持しつつ加工変質層を除去し、平面粗さを改善し、特に局所的なファセットをより浅く、滑らかな凹凸形状を持ち、パーティクルや汚染の発生しにくいエッティング表面を有するウェーハを作製することが可能となる。

一方、デバイスプロセスの搬送系でのウェーハ有無の検知はウェーハ裏面により行われているため、表面を鏡面研磨したウェーハ裏面が鏡面状であると、検知困難や誤検知するなどの問題が生じていた。

【特許文献1】特開平11-233485号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

上記特許文献1に示されたウェーハの表面を鏡面研磨したウェーハ（以下、PW；Polished Waferという。）では、デバイスメーカーの所望するような良好な平坦度を有し、かつPWの裏面粗さが小さいウェーハを得られることができない問題があった。

## 【0006】

本発明の目的は、ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減し得るシリコンウェーハの加工方法を提供することにある。

本発明の別の目的は、表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハの加工方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0007】

請求項1に係る発明は、ラッピング工程に続いて洗浄工程を経た加工変質層を有するシリコンウェーハをフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液にリン酸が含有する酸エッティング液に浸漬させてウェーハをエッティングするシリコンウェーハの加工方法である。

請求項1に係る発明では、フッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液にリン酸を含有した酸エッティング液によりエッティングを施すと、ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減することができる。

【0008】

請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明であって、フッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液を100重量%としたとき、酸水溶液はリン酸を30～40重量%含有する加工方法である。

【0009】

請求項3に係る発明は、図1に示すように、複数のエッティング槽に酸エッティング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程11に続いて洗浄工程12を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬するエッティング工程13と、エッティングされたウェーハの片面を鏡面研磨する表面鏡面研磨工程18と、表面鏡面研磨されたウェーハを洗浄する洗浄工程19とを含むシリコンウェーハの加工方法の改良であり、その特徴ある構成は、エッティング工程13が酸エッティングの後にアルカリエッティングが行われる工程であって、酸エッティング液がフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液100重量%にリン酸30重量%以上を含有するところにある。

請求項3に係る発明では、上記工程11～工程19を経ることにより、表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハを得ることができる。

【0010】

請求項4に係る発明は、請求項3に係る発明であって、図1に示すように、エッティング工程13と、表面鏡面研磨工程18との間にエッティング工程13で形成されたウェーハ裏面の凹凸の一部を研磨する裏面軽研磨工程17を更に含む加工方法である。

請求項4に係る発明では、裏面軽研磨工程をウェーハ裏面に施すことで裏面の粗さが低減される。

【0011】

請求項5に係る発明は、請求項3に係る発明であって、フッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液を100重量%としたとき、酸水溶液はリン酸を30～40重量%含有する加工方法である。

【0012】

請求項6に係る発明は、請求項3に係る発明であって、エッティング工程13における酸エッティングを、シリコンウェーハへ酸エッティング液を滴下し、ウェーハをスピinnさせることにより滴下した酸エッティング液をウェーハ表面全体に拡げてエッティングするスピinnコト法により行う加工方法である。

【発明の効果】

【0013】

以上述べたように、本発明の加工方法によれば、フッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液にリン酸を含有した酸エッティング液によりエッティングを施すと、ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減できる。

また、加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬するエッティング工程と、エッティングされたウェーハの片面を鏡面研磨する表面鏡面研磨工程と、表面鏡面研磨されたウェーハを洗浄する洗浄工程とを含み、エッTING

グ工程が酸エッティングの後にアルカリエッティングが行われ、酸エッティング液がフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液100重量%にリン酸30重量%以上を含有する本発明のシリコンウェーハの加工方法を施すことにより、表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハを得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

次に本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。

先ず、育成されたシリコン単結晶インゴットは、先端部及び終端部を切断してブロック状とし、インゴットの直径を均一にするためにインゴットの外径を研削してブロック体とする。特定の結晶方位を示すために、このブロック体にオリエンテーションフラットやオリエンテーションノッチを施す。このプロセスの後、ブロック体は棒軸方向に対して所定角度をもってスライスされる。

スライスされたウェーハは、ウェーハの周辺部の欠けやチップを防止するためにウェーハ周辺に面取り加工する。この面取りを施すことにより、例えば面取りされていないシリコンウェーハ表面上にエピタキシャル成長するときに周辺部に異常成長が起こり環状に盛り上がるクラウン現象を抑制することができる。図1に示すように、スライスで生じたウェーハ表面の凹凸層を機械研磨（ラッピング）してウェーハ表面の平坦度とウェーハの平行度を高める（工程11）。ラッピング工程11を施したウェーハは洗浄工程12で洗浄されて次工程へと送られる。

【0015】

次いで、面取りやラッピング工程11により導入された機械的なウェーハ表面の加工変質層をエッティングによって完全に除去する（工程13）。

本発明のエッティング工程13では、複数のエッティング槽に酸エッティング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、シリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬する。またエッティング工程13は酸エッティング13aの後にアルカリエッティング13bが行われる。この順にそれぞれエッティングされたウェーハの表面は、形状の大きいファセットが少なくかつ深いピットの発生も抑制される。またエッティング工程13における酸エッティングを、シリコンウェーハへ酸エッティング液を滴下し、ウェーハをスピinnさせることにより滴下した酸エッティング液をウェーハ表面全体に拡げてエッティングするスピinnコート法により行ってもよい。

【0016】

酸エッティング13aに用いられる酸エッティング液はフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液100重量%にリン酸30重量%以上が含有する。リン酸を30重量%以上含有した酸エッティング液を用いることにより、ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減することができる。酸エッティング液はフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液を100重量%としたとき、リン酸が30～40重量%含有するように調製されることが好ましい。

アルカリエッティング13bに用いられるアルカリエッティング液は水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムが含まれ、更に、水酸化リチウムを含んでもよい。

【0017】

また、各エッティング工程の間には rinsing 工程を行う必要がある。例えば酸エッティング工程13aとアルカリエッティング13bとの間には、純水 rinsing を施す洗浄工程14が設けられる。rinsing 洗浄工程14を間に入れることにより、ウェーハに付着した酸やアルカリが洗い落とされるため次に続く工程において、前工程のエッティング槽からの薬液の持込みを防ぐことができ、薬液組成の変動を最小限に抑制することができる。

エッティング工程13を終えたウェーハは洗浄工程16で表面に付着した薬液が洗い流されて次工程へと送られる。

【0018】

次に、エッティング工程13で形成されたウェーハ裏面の凹凸の一部を研磨する裏面軽研磨工程を行う（工程17）。この裏面軽研磨をウェーハ裏面に施すことにより裏面の粗さ

が低減される。

裏面軽研磨工程17及び次に続く表面鏡面研磨工程18では片面研磨方法が用いられる。これらの工程17, 18で使用される研磨装置は片面研磨装置を用いてもよいし、両面研磨装置を用いて片面研磨を行ってもよい。裏面軽研磨工程17によるウェーハ裏面の研磨代は $1\text{ }\mu\text{m}$ 以下とする。好ましくは $0.3\text{ }\mu\text{m}$ 以下である。 $1\text{ }\mu\text{m}$ を越えると、光沢度がデバイスマーカーの所望する数値とならず表裏面の区別がつきにくくなる。この裏面軽研磨17によりウェーハ裏面の形状は、裏面の粗さが所定の範囲に抑えられる。

### 【0019】

裏面軽研磨工程17を終えたウェーハは、その表面を機械的ないし物理的研磨と化学的研磨とを組合せた鏡面研磨することにより、光学的光沢をもち加工歪みのない鏡面ウェーハにされる（工程18）。

表面鏡面研磨を終えたウェーハは洗浄され（工程19）、デバイス製造プロセスへと送られる。本発明の工程11～工程19を経ることにより、表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハを得ることができる。

### 【実施例】

#### 【0020】

次に本発明の実施例を比較例とともに詳しく説明する。

##### ＜実施例1＞

先ず、シリコン単結晶インゴットをスライスし、面取り、ラッピングに続いて洗浄を経た加工変質層を有するシリコンウェーハを用意した。フッ酸、硝酸、リン酸及び水を体積比（HF : HNO<sub>3</sub> : H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> : H<sub>2</sub>O）が1 : 8 : 6 : 5となるように混合して酸エッティング液を調製した。調製した酸エッティング液をエッティング槽に貯え、液温を80°Cに維持した。48重量%の水酸化カリウムを含むアルカリエッティング液を調製し、このアルカリエッティング液をエッティング槽に貯え、液温を80°Cに維持した。

次いで、酸エッティング槽内の酸エッティング液を攪拌しながら上記ウェーハを浸漬してウェーハの取り代を表面と裏面を合わせた合計で $20\text{ }\mu\text{m}$ となるように酸エッティングを行った。酸エッティングを終えたウェーハを超純水に浸漬してリーンスを行った。

次に、アルカリエッティング槽内のエッティング液を攪拌しながら上記ウェーハを浸漬してウェーハの取り代を表面と裏面を合わせた合計で $5\text{ }\mu\text{m}$ となるようにアルカリエッティングを行った。アルカリエッティングを終えたウェーハを超純水に浸漬してリーンスを施してウェーハを得た。

#### 【0021】

##### ＜実施例2＞

酸エッティングにおけるウェーハの取り代を表面と裏面を合わせた合計で $12\text{ }\mu\text{m}$ とし、アルカリエッティングにおけるウェーハの取り代を表面と裏面を合わせた合計で $11\text{ }\mu\text{m}$ とした以外は実施例1と同様にしてエッティングを行った。

#### 【0022】

##### ＜比較例1＞

フッ酸、硝酸、酢酸及び水を体積比（HF : HNO<sub>3</sub> : CH<sub>3</sub>COOH : H<sub>2</sub>O）が1 : 8 : 6 : 5となるように混合して酸エッティング液を調製し、酸エッティングにおけるウェーハの取り代を表面と裏面を合わせた合計で $12\text{ }\mu\text{m}$ とし、アルカリエッティングにおけるウェーハの取り代を表面と裏面を合わせた合計で $12\text{ }\mu\text{m}$ とした以外は実施例1と同様にしてエッティングを行った。

#### 【0023】

##### ＜比較試験及び評価＞

実施例1, 2及び比較例1で得られたウェーハ表面の所定位置を表面粗さ測定装置を用いて走査し、表面粗さ測定を行った。表面粗さの測定結果を図2～図4に、各表面粗さ測定結果における平均ラフネスR<sub>a</sub> (average roughness)、平方根平均ラフネスR<sub>ms</sub> (root-mean-square roughness) 及びラフネスの最大値R<sub>p-v</sub> (peak-to-valley) を表1にそれ

それ示す。なお、図2～図4における $L_{ms}$ は平均表面レベル (mean surface level) を示す。

## 【0024】

【表1】

	酸エッティング液	表裏面合計取り代 [ $\mu m$ ]		平均ラフネス $R_a$ [ $\text{\AA}$ ]	平方根平均ラフネス $R_{ms}$ [ $\text{\AA}$ ]	ラフネスの最大値 $R_{p-v}$ [ $\text{\AA}$ ]
		酸	アルカリ			
実施例 1	フッ酸：硝酸：リン酸：水=1:8:6:5	20	5	2452.80	3165.09	24870.80
〃 2	フッ酸：硝酸：リン酸：水=1:8:6:5	12	11	2932.65	3764.69	31172.44
比較例 1	フッ酸：硝酸：酢酸：水=1:8:6:5	12	12	4119.73	5223.79	36016.68

## 【0025】

図4及び表1より明らかなように、酢酸を含む酸エッティング液を用いてエッティングを行った比較例1では、表面粗さが大きく、表面高さの絶対値を示す $R_{p-v}$ も大きな数値を表している。これに対して図2及び図3より明らかなように、実施例1及び2では、同様の製造条件にもかかわらず表面粗さが大幅に改善されていることが判る。特に酸エッティングによる合計取り代の割合を大きくした実施例1は更なる表面粗さの低減を図ることが判ることが判る。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0026】

【図1】本発明のシリコンウェーハの加工方法を示す工程図。

【図2】実施例1で得られたウェーハの表面粗さ測定図。

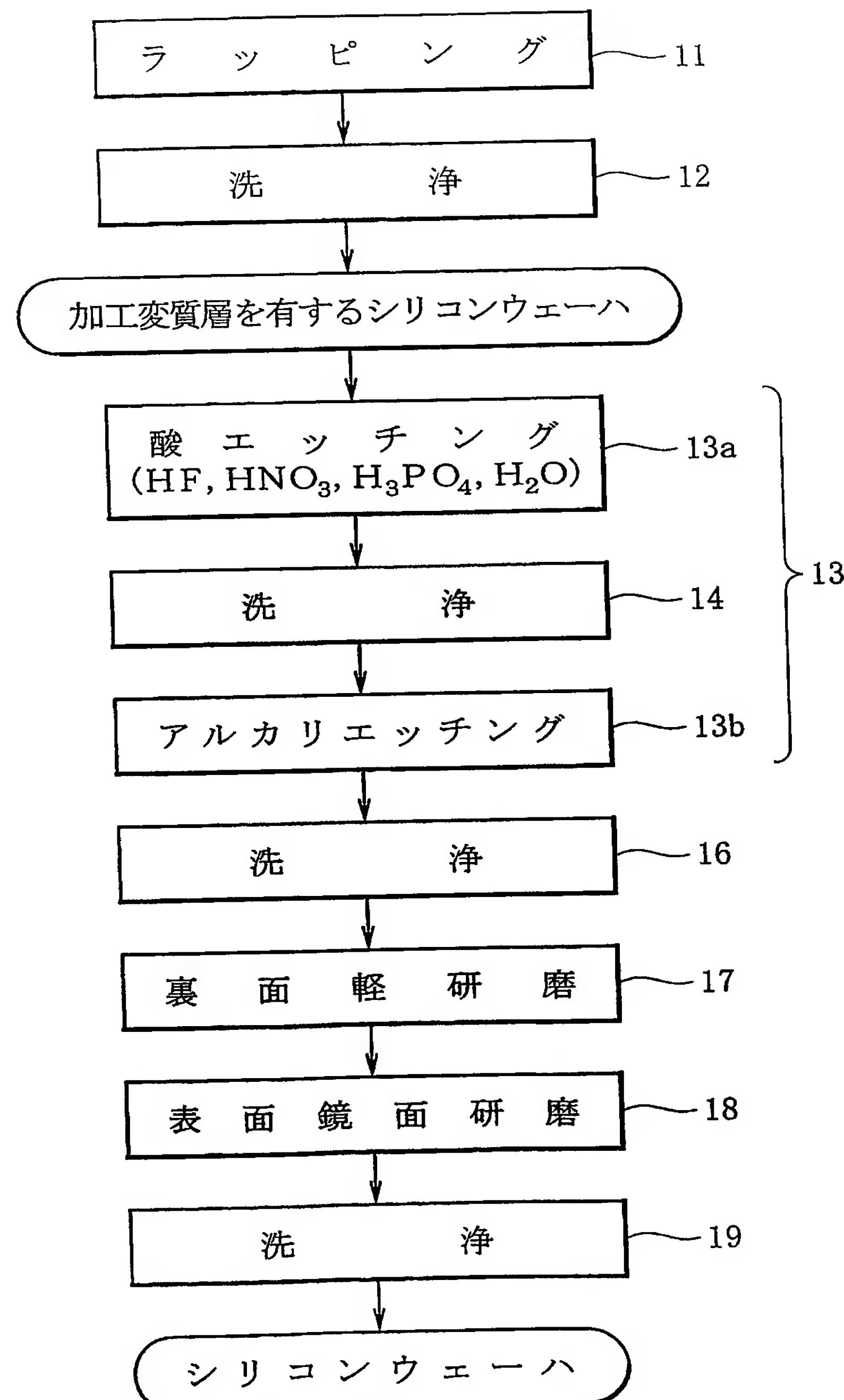
【図3】実施例2で得られたウェーハの表面粗さ測定図。

【図4】比較例1で得られたウェーハの表面粗さ測定図。

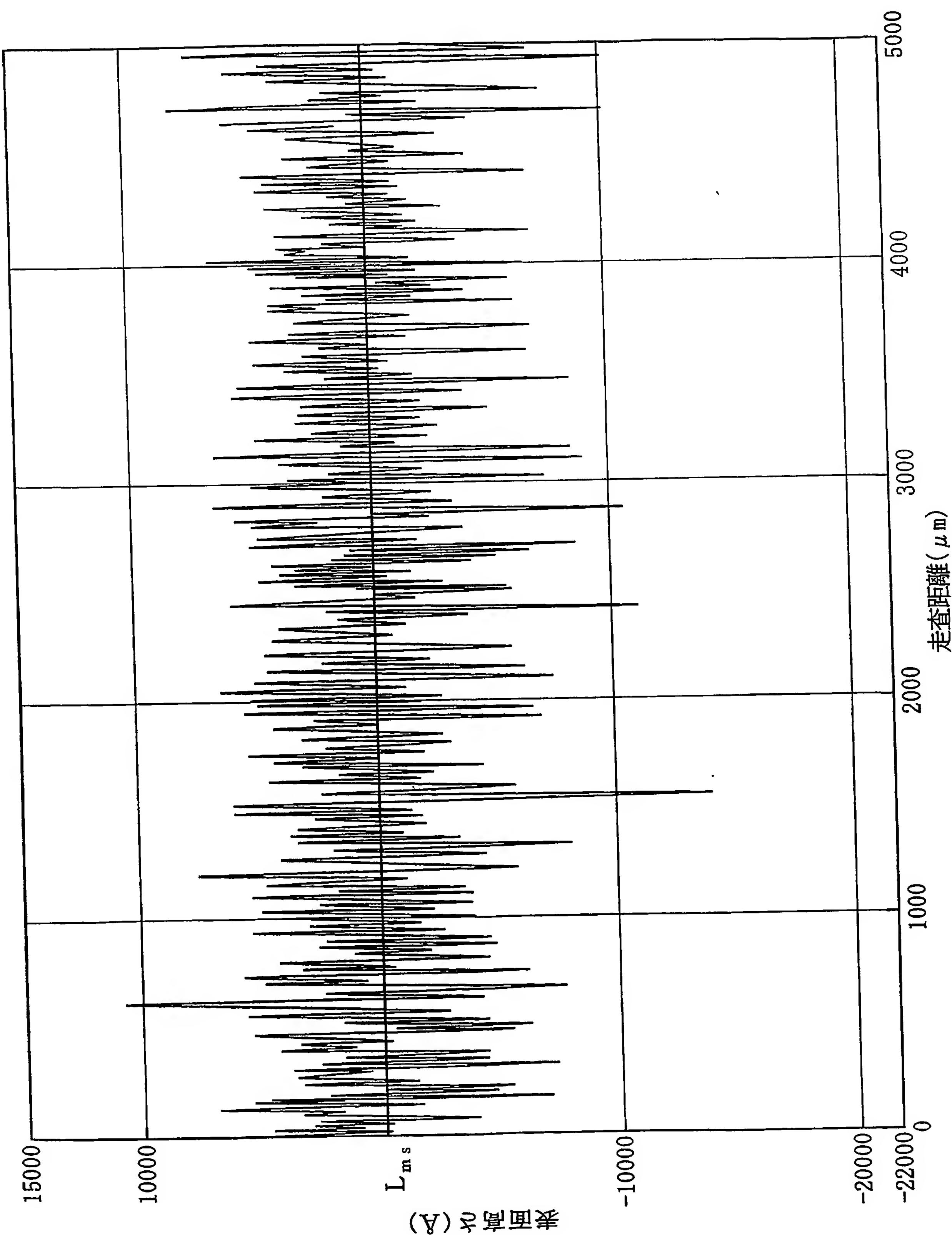
## 【符号の説明】

## 【0027】

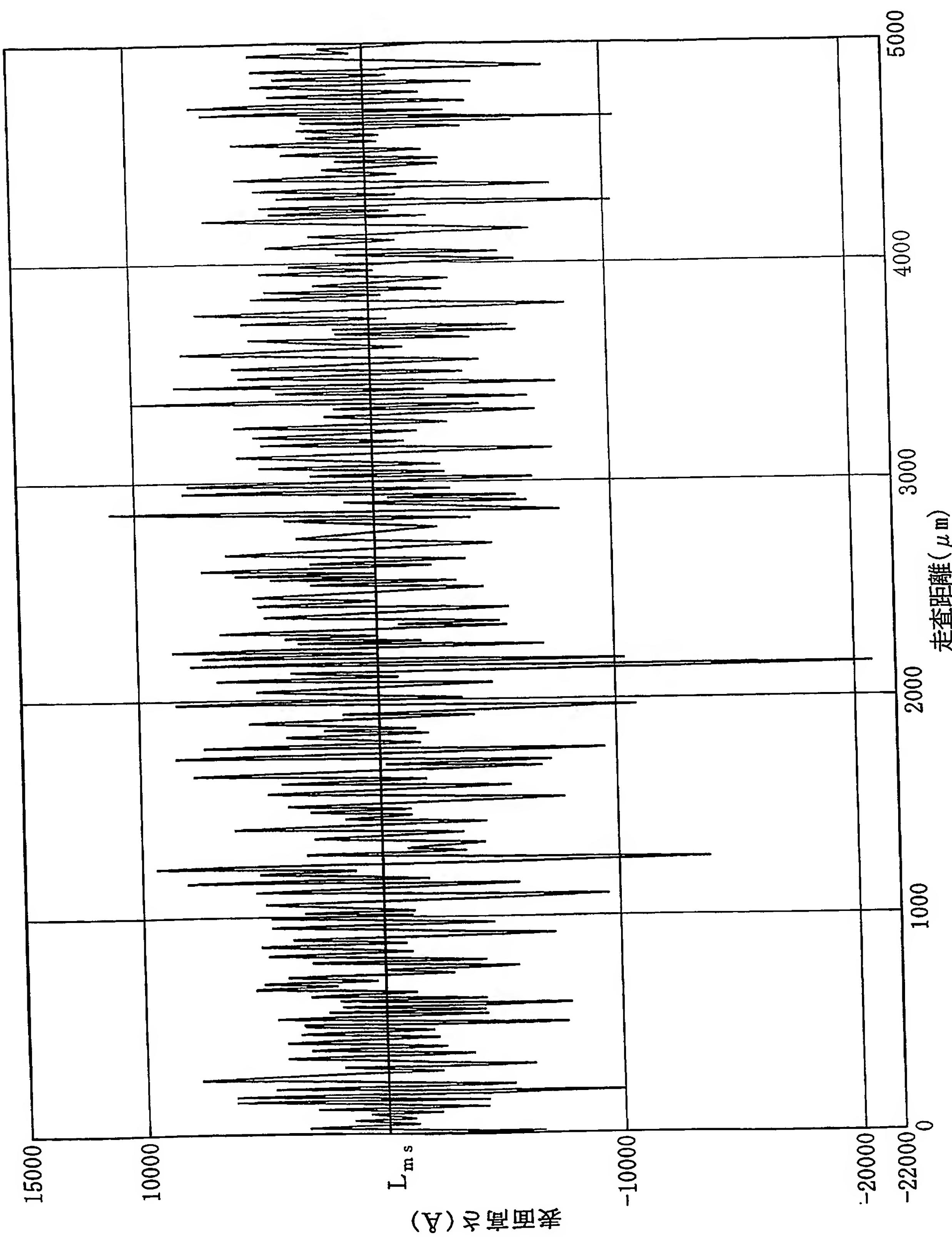
- 1 1 ラッピング工程
- 1 2 洗浄工程
- 1 3 エッティング工程
- 1 3 a 酸エッティング
- 1 3 b アルカリエッティング
- 1 7 裏面軽研磨工程
- 1 8 表面鏡面研磨工程
- 1 9 洗浄工程

【書類名】 図面  
【図1】

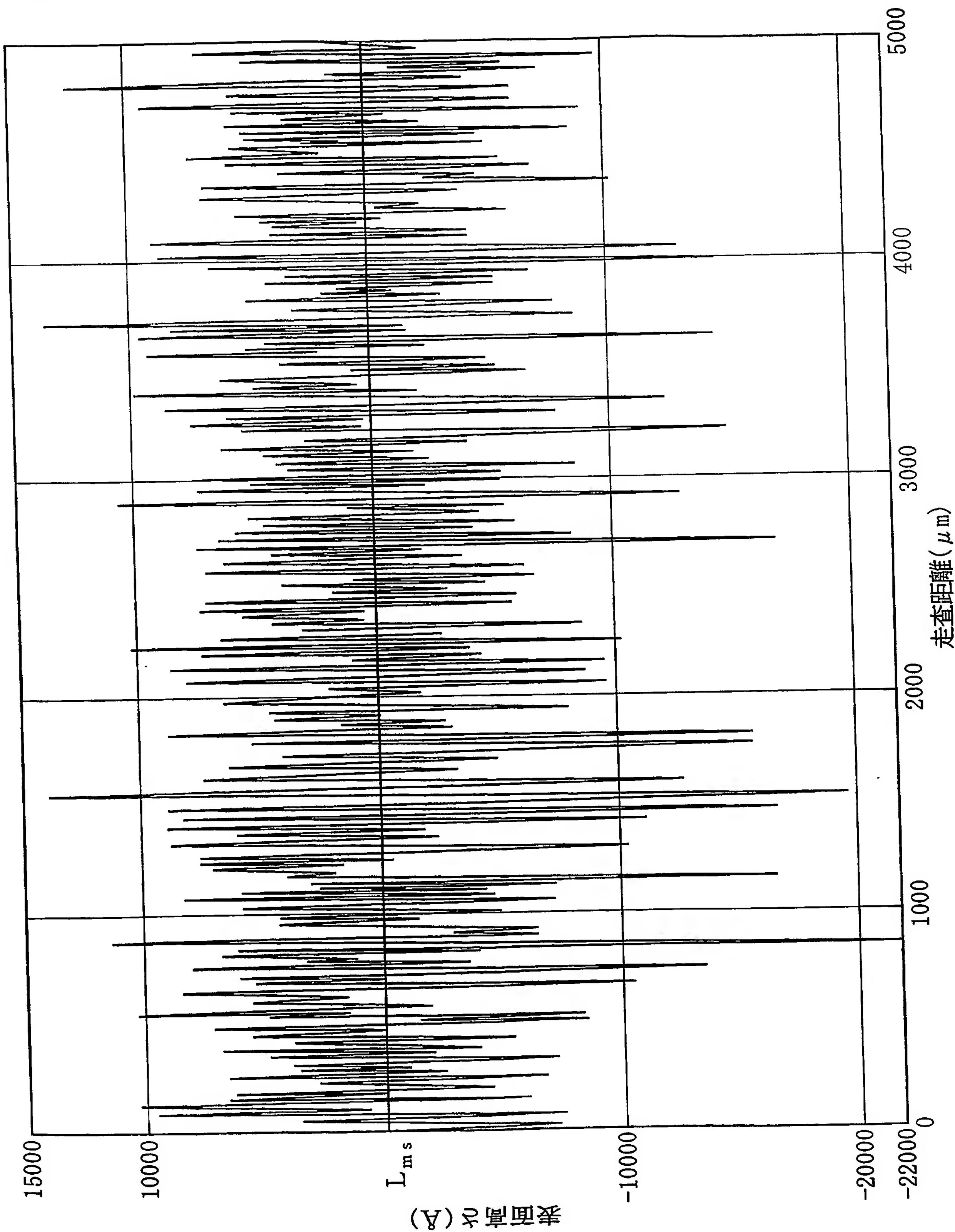
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減し得る加工方法を提供する。表面を鏡面研磨したウェーハにおいて、良好な平坦度を得、かつ裏面粗さが小さくなるシリコンウェーハの加工方法を提供する。

【解決手段】本発明のシリコンウェーハの加工方法は、複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程11に続いて洗浄工程12を経た加工変質層を有するウェーハを酸エッチング液とアルカリエッチング液とに順次浸漬するエッチング工程13と、エッチングされたウェーハの片面を鏡面研磨する表面鏡面研磨工程18と、表面鏡面研磨されたウェーハを洗浄する洗浄工程19とを含み、エッチング工程が酸エッチングの後にアルカリエッチングが行われる工程であって、酸エッチング液がフッ酸及び硝酸を主成分とする酸水溶液100重量%にリン酸30重量%以上を含有することを特徴とする。

【選択図】図1

特願 2003-411287

出願人履歴情報

識別番号 [302006854]

1. 変更年月日 2002年 1月31日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都港区芝浦一丁目2番1号  
氏名 三菱住友シリコン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**